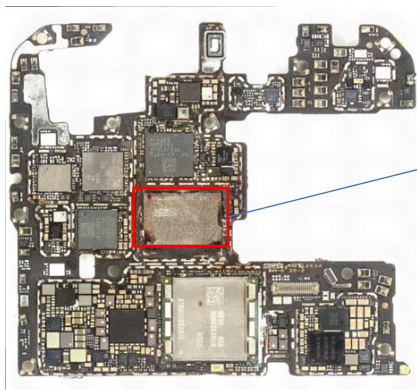


## 4D NAND フラッシュメモリ：SK hynix (HUAWEI Mate 80 Pro搭載) 構造解析レポート



HUAWEI Mate 80 Pro搭載基板



3D NAND パッケージ

### レポート背景と概要

生成AIとデータセンターの爆発的な拡大により、大容量且つ高速な3D/4D NANDフラッシュメモリの需要が急拡大しています。

今回、2025年11月に発売されたHUAWEI Mate 80 Pro搭載のSK hynix製4D NANDフラッシュメモリの構造解析レポートをリリースします。

### 製品特徴

HUAWEI Mate 80 Pro搭載品 製品リリース日(Mate 80 Pro)：2025年11月

SK hynix 4D NANDフラッシュメモリ

### 解析内容 & レポート価格

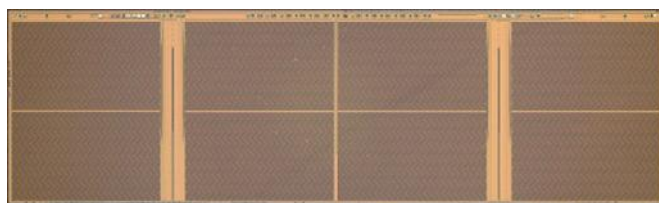
構造解析レポート 価格：¥300,000 (税別) 発注後1weekで納品

- ・1PKG内にフラッシュメモリチップは、8チップ搭載され、インターフェースICチップも搭載されている。
- ・概要解析として、メモリセル部断面解析(WL, BL方向)を行い、構造確認、メモリゲート積層数の確認、を行っています。

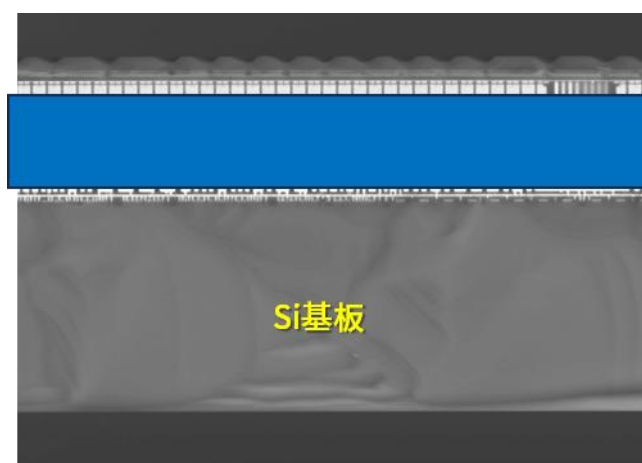
## 構造解析レポート目次

	Page
1. デバイスサマリー . . .	3
2. 製品分解 . . .	4
3. パッケージ観察 . . .	5
4. X線観察 . . .	6
5. チップ観察 . . .	7
6. 断面構造解析 . . .	10

## 構造解析レポートからの抜粋



4D NANDチップ写真



メモリセルの断面SEM像